



株主・投資家のみなさまへ

第50期 年次報告書 2009.4.1—2010.3.31

● 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日
公告方法	電子公告により、当社ホームページ (http://www.jcu-i.com/)に掲載いたします。なお、 やむを得ない事由により、電子公告によることが できないときは、日本経済新聞に掲載して行うもの とします。
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
電話お問合わせ先・ 郵便物送付先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)
証券コード	4975
金融商品取引所	東京証券取引所市場第一部



荏原ユーザライト株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7
TEL: 03-3833-0321 FAX: 03-3833-5075
<http://www.jcu-i.com/>

株主さま向けアンケート 株主のみなさまの 声をお聞かせください

当社では、株主のみなさまの声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、
アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。
所要時間は5分程度です。

 <http://www.e-kabunushi.com>
アクセスコード 4975

Yahoo!、MSN、exciteのサイト
内にある検索窓に、いいかぶと
4文字入れて検索してください。


kabu@wjim.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。


QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。



●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

 ※本アンケートは、株式会社エーツメディアの提供する「e-株主リサーチ」
サービスにより実施いたします。(株式会社エーツメディアについての詳細
<http://www.a2media.co.jp>) ※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させ
ていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問合わせ TEL: 03-5777-3900 (平日 10:00~17:30)
「e-株主リサーチ事務局」 MAIL: info@e-kabunushi.com



株主・投資家のみなさまへ

株主・投資家のみなさまには、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社の当期の決算は、連結で売上高91億97百万円、営業利益5億26百万円、経常利益5億48百万円、当期純利益2億92百万円となりました。当期特筆すべきことは、当期純利益の3分の2を海外子会社が貢献してくれたことでもあります。

1 国内の状況

国内の上半期の状況につきましては、日本の自動車関連産業は低迷が続きましたが、政府によるエコカー減税の効果もあり、漸次回復の基調となりました。下半期は中国、米国向け等の需要も次第に好転し、ピーク時の85%まで回復いたしました。従いまして、来期には本格的な回復が期待されています。

一方、半導体、プリント配線板の事業につきましては、海外主導で上半期より回復基調となっておりますが、下半期はほぼ好調時の水準まで回復しております。

これは、携帯電話の多機能化やスマートフォンのような情報端末の機能多角化や小型パソコン等のヒット商品化、加えて、Windows7等の新規ソフトの投入等リーマンショック後相次ぎ発売された新製品、また、地上デジタル対応の薄型テレビや家電製品に対するエコポイントの優遇策等が功を奏したものと考えられます。従いまして、本当の意味での国内景気回復や消費、設備投資、雇用の本格的回復の実態は来期にならないとわからないというのが正直な見方でございます。

2 海外の状況

海外の自動車関連産業は中国を筆頭に、韓国、タイ等を中心として、おおむね期初より順調に推移してまいりました。特に中国の自動車業界の発展ぶりは目覚しく、中でも電気自動車への移行が鮮明となってきております。

日本の自動車メーカーも期初には米国での販売や国内需要の落ち込みから苦戦を強いられておりましたが、中国、タイ等では比較的堅調に推移しておりました。特に本年2月、3月と米国自動車市場も驚くほど活発となり、自動車各社の今期決算により影響をもたらしたものと理解しております。しかしながら、本当の復興については今しばらく業績の推移を見守る必要があります。

一方、半導体、プリント配線板の業界については、韓国、台湾、中国とも期初より急回復し、下半期はリーマンショック前の状況までの100%近く回復し、積極的な設備投資計画が相次いで発表されており、当社としても、来期に大きな期待をしております。台湾のプリント配線板メーカーの投資は国内のみならず、中国への投資も盛んになりつつあります。また、韓国のサムソン、LG等大手も投資目的を絞って大型投資を行っております。

日本の国内メーカーの投資意欲の減退ぶりは目を覆いたくなる状況で、日本の半導体、プリント配線板メーカーの将来を考えると、淋しい限りです。

3 来期の戦略

国内外の状況を踏まえて、当社の来期の戦略は以下の通りです。

1 ニッケル/パラジウム/金めっきプロセスのラインテストの開始

Ni/Pd/Auプロセス(SKYLITE)の他社との比較テストが終わり、当社プロセスが他社を圧倒した評価を得て、本格的なラインテストが開始されました。その液寿命が客先要求に叶えば、正式採用となります。長年の夢が実現し、貴金属めっき分野への本格参加ができる見通しです。

2 株式会社荏原電産のプリント配線板関連事業の譲受

今年3月末日をもって株式会社荏原電産プリント配線板関連事業を譲り受け、4月1日からの新入社員を合わせ、35名の社員を迎え入れました。株式会社荏原電産のプリント配線板関連事業は、従来より国内外とも当社で販売していた経緯もあり、大きなシナジー効果が挙げられるものと期待し、努力してまいり所存でございます。

3 フロントライン 拡販チームの活躍

今期は台湾、韓国、中国において、プリント配線板用新製品(VFⅣ、TFⅡ等)の拡販に成功し、大きな成果がありました。来期も引き続き新製品(低パラジウムPTH、プリント配線板対応銅ポスト用C-POS、SKYLITE:貴金属めっきプロセス等)の拡販に邁進してくれるものと期待しております。

4 スパッタリングによるカラーリング事業

中国の深圳 森科社との合弁事業としてスタートし、中国政府の事業認可がやっと4月24日を下りたものの、環境監査やその他の諸書類の審査認可が大幅に遅れた次第です。しかし、本装置は2月には搬入され、5月連休明けに本格稼働できる目途がついてきました。勝負はこれからですが、評判は上々ですのでご安心ください。

5 プラズマ装置

第四紀韓国社との共同事業としてスタートしましたが、今期は5基の受注があり、順調に評価が出てきております。来期も引き続き拡販に努力致しますので、ご期待ください。

6 ボルトナット、ビス等のコーティング事業と太陽光パネルの反射防止膜事業について

台湾のNanmat社との合弁事業として始まり、新聞紙上に発表したのを契機に多くのお問い合わせをいただきました。サンプル作業も軌道に乗り、後一步のところまで来ております。来期に向けて最大のターゲット商品になるものと大いに期待しております。

7 装置部門の海外展開

中国、台湾、韓国、タイ、ベトナム等からめっき装置の引き合いが増加しております。海外での生産計画や装置メーカーとの連携も視野に入れ、積極的な海外展開を図りたいと考えております。

8 太陽光パネルの設置事業に参入

今期は2社へ太陽光パネルの設置を完了しており、引き続き積極的に展開する所存であります。まためっき装置の販売と合わせ、当社のめっき排水回収装置も環境問題へより一層貢献できるよう頑張りますので、ご支援ください。

最後に、今期はリーマンショックからの脱出に全力を挙げてまいりました結果、当初計画より事業業績が好転し、来期に向けた対策も以上のように計画しておりますので、株主・投資家のみなさまにはなお一層のご支援、ご協力を賜りますよう重々お願い申し上げます。



荏原ユーザライト株式会社
代表取締役会長
兼最高経営責任者

粕谷佳允

荏原ユーザライト株式会社
代表取締役社長
兼最高執行責任者

小澤恵二

株式会社荏原電産から、プリント配線板関連事業を譲り受けました。

◆事業譲受の背景

当社は表面処理総合リーディングカンパニーを目指し、時代の要求に即した研究開発を行っております。これまでも、「薬品と装置」の総合技術によって各種めっき工程を中心に、お客様目線での提案を続け、独自の地位を築いてきました。

今回は当社が得意とするプリント配線板業界で、更なる成長を目指すため、2010年3月31日に株式会社荏原電産のプリント配線板関連事業を譲り受けることといたしました。

今後は、当社が有する既存めっき事業と新たなエッチング事業の相乗効果により、一層付加価値の高いサービスを提供できるものと考えています。

◆既存事業において期待される相乗効果について

【薬品関連】

譲受事業の薬品関連は、主にプリント配線板製造工程に使用する薬品を製造販売しております。特に銅エッチング処理薬品が主要製品です。

電子機器の小型化・高性能化に伴い、半導体に直接搭載するパッケージ基板等においては、高密度及び高細線化が要求されてきております。そこで当社はドライフィルムや液状レジストと銅の密着性を向上させるネオブラウンをはじめ、均一に銅のエッチダウンを可能としたハイパーエッチ、SAPやMSAP用の回路形成用エッチング液であるSACやFEを提供しております。

また薬品の技術開発も既存のめっきプロセス及びエッチング技術を融合することで、最先端技術をトータルプロセスとしてお客様にご提案できると確信しております。

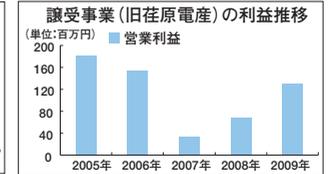
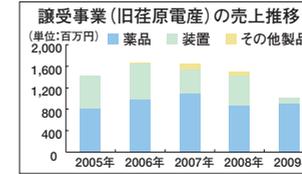
【装置関連】

装置関連としては、主に各種前処理、デスマア、現像・エッチング・剥離、ハーフエッチ等の装置を取り扱っております。エレクトロニクス製品の心臓部であるプリント配線板製造プロセスでは、当社の数々の薬品が使用されており、プリント配線板製造に水平処理装置も使われております。

電子機器(PC、薄型テレビ、携帯電話等)の軽薄短小化や高付加価値化、及び低コスト化が進む中、プリント配線板もより薄く、小さくなってきております。こうした市場ニーズに合わせ、今後は、装置に求められる薬品との融合・搬送技術・生産性の効率化も考え、今まで培ったエッチング技術を最大限に活かし、最先端装置を開発していきたいと思っております。

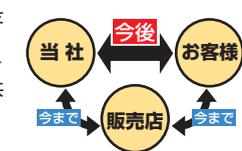


◆売上・利益



◆海外展開

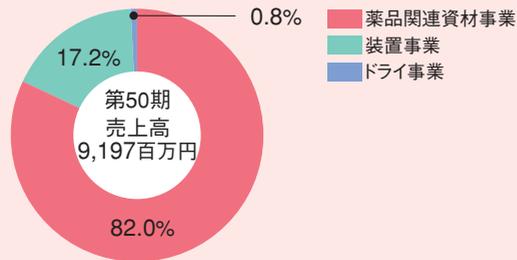
プリント配線板関連事業は、中国・台湾・韓国・タイ・ベトナムを中心に市場開拓を行ってきました。現地生産は現在中国、タイで行っておりますが、今後更に需要動向に応じて増やす予定です。これからは、当社の現地法人を通じて、既存めっきプロセスとの相乗効果を活かし、お客様に更なる良質なサービスを提供していきたいと思っております。



【セグメント別業績概況】当社の製品・事業内容について、セグメント別概況とともにご紹介いたします。

当社グループは、当社と子会社8社及び関連会社2社により構成されており、表面処理用薬品関連資材、表面処理用装置及び表面処理用ドライ装置を、自動車、住宅、エレクトロニクス産業等様々な表面処理分野に提供する表面処理総合メーカーであります。

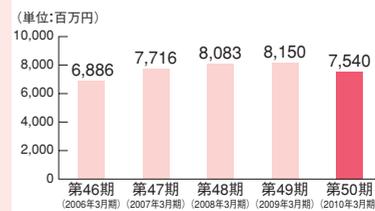
● 事業部門別売上高構成比率



● 薬品関連資材事業

薬品関連資材事業におきましては、自動車産業向け、エレクトロニクス産業向け、ともに薬品の販売は前年同期を下回り、売上高は75億40百万円(前年同期比7.5%減)となりました。しかし、営業利益は、売上原価及び販売管理費の減少により前年同期を上回り、14億89百万円(前年同期比14.9%増)となりました。

■ 薬品関連資材事業の売上高推移



● 装置事業

装置事業におきましては、設備投資の低迷により売上高は15億80百万円(前年同期比38.8%減)となりました。この結果、営業損失は15百万円(前年同期は営業利益1億61百万円)となりました。

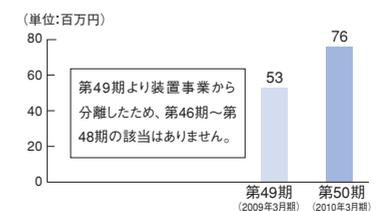
■ 装置事業の売上高推移



● ドライ事業

ドライ事業におきましては、売上高は76百万円(前年同期比43.1%増)となりましたが、営業費用の増加により、営業損失は2億59百万円(前年同期は営業損失1億70百万円)となりました。

■ ドライ事業の売上高推移



無電解ニッケル/パラジウム/金(Ni/Pd/Au)^{*}めっき技術を中心とした、プリント配線板(電子)分野へのトータルソリューションの提案

新プロセスの主な用途 / 今回ご紹介するのは、携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラや携帯音楽プレーヤー等、昨今の小型電子機器に必要な技術です。

無電解Ni/Pd/Auめっきプロセス

※Ni/Pd/Au …ニッケル/パラジウム/金

JCU SKYLITE

図1 半導体チップと電子回路基板の電気的接続方法

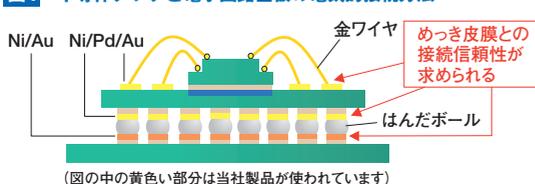
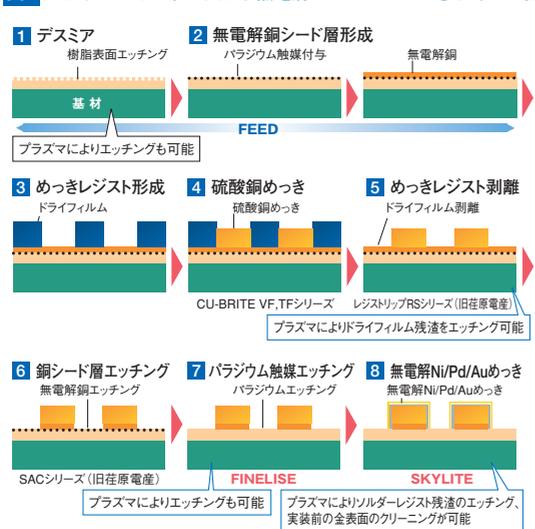


図2 セミアディティブ工法から無電解Ni/Pd/Auめっきまでの工程



◆ 新プロセスの開発背景

小型電子機器の高性能化は、それを駆動するLSIによって決定されます。近年、このLSIの回路幅は32nmにまで達しており、当然ながらこのLSIと接続されるパッケージ基板の回路幅も年々狭くなってきています。パソコン用のCPUに使用されるFC(フリップチップ)基板や、携帯電話等のモジュールに使用されるCSP(チップサイズパッケージ)基板では、すでにL/Sは20μm/20μmにまで達しています。このような基板では、最終めっき工程となる無電解Ni/AuやNi/Pd/Auめっきにおいて、ブリッジと称される配線の短絡不良が増えてきます。

さらに、金ワイヤや、はんだボールとの接続信頼性という観点では、金は厚く付けた方が好ましいのですが、コストの面ではむしろ薄い方が好ましいのです。この悩ましい問題も解決できるのが、当社が開発した「SKYLITE」プロセスです。このプロセスの特長は、

- 従来のワイヤボンディング用Ni/Auよりも一般にAuの膜厚を薄くできるNi/Pd/Auを用いています。
- 従来のNi/Auで問題とされたNiの腐食を強く抑えます。
- 従来よりもブリッジのしにくい各種Ni、Pd、Auめっきを用いています。特にPdは他社と差別化のできるユニークな組成を用いています。
- SKYLITEのブリッジ抑制には、前処理で用いるFINELISE処理も寄与しています。

我々は、今後益々配線幅の狭くなるFC基板やCSP基板の回路形成に対し、このSKYLITEをご提案していきたいと考えています。

予め樹脂基板にめっきレジスト処理といわれる、必要な部分だけにめっきが付くようパターン形成をしておき、そこに必要な部分だけめっきを成膜し、後処理で仕上げる方法をセミアディティブ工法といいます。近年、電子機器の小型化や高密度化に対応するため、このセミアディティブ工法が用いられています。ここで紹介する当社の貴金属技術は、このセミアディティブ工法に使用されるものです。図2に示すセミアディティブ工法で使用したパラジウム触媒を、FINELISEプロセスで除去し、その後に無電解Ni/Pd/Auめっきを行うことで、図3に示すようなファインパターンに選択析出性のよいめっきができるようになります。

◆ 当社の販売戦略

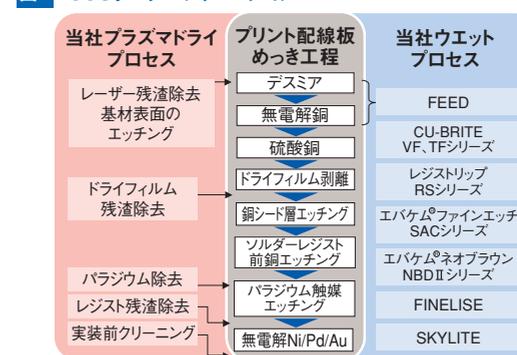
今年4月、株式会社荏原電産よりプリント配線板関連事業を譲り受け、当社が苦手としていたエッチング技術と当社が得意とするウェットめっき技術、ドライプラズマ技術を組み合わせることが可能となりました。これにより、最先端基板に対応したスペシャリティ産業と、前処理から後処理までのトータルソリューションをご提供できるコモディティ産業への両分野への対応ができるようになります。

今後もウェット、ドライ、エッチングの3事業融合によるシナジー効果を利用し、これまで対応ができなかった表面処理にも適応できるよう鋭意検討をしていきたいと思ひます。

図3 選択析出性 (L/S=15/15μm)



図4 JCUトータルソリューション



● 技術的な補足説明

L/S: Line & Space

プリント配線板産業によく出ている専門用語で、ライン アンド スペースと読みます。樹脂基板の上に回路形成された銅配線の幅をライン、銅配線と銅配線の間にある樹脂部の幅をスペースといい、単位にはμmが使用されます。前述のように、最近の電子機器では高密度化が進みL/Sが12μm/12μmにも達しているものがあります。

連結財務諸表(要旨)

連結貸借対照表

区分	当期末 2010年3月31日現在	前期末 2009年3月31日現在
【資産の部】		
流動資産	6,137,616	6,437,244
現金及び預金	2,071,624	2,704,533
受取手形及び売掛金	2,843,309	2,209,204
商品及び製品	483,492	398,764
仕掛品	93,299	516,074
原材料及び貯蔵品	207,024	232,540
繰延税金資産	175,987	96,640
その他	290,835	300,792
貸倒引当金	△ 27,956	△ 21,304
固定資産	4,718,834	4,360,157
有形固定資産	2,813,310	3,102,982
① 無形固定資産	416,425	65,255
投資その他の資産	1,489,097	1,191,919
資産合計	10,856,450	10,797,402

- ① 無形固定資産の増加は、主に株式会社荏原電産のプリント配線板製造用工業薬品及び装置の製造及び販売に関する事業を譲り受けたことに伴うのれんの増加であります。
- ② 資本金、資本剰余金の増加は、公募増資による増加、第三者割当増資による増加及び新株予約権の権利行使に伴う増加であります。
- ③ 自己株式の減少は、自己株式の処分(引受人の買取り受けによる売出し)によるものであります。

(単位:千円)

区分	当期末 2010年3月31日現在	前期末 2009年3月31日現在
【負債の部】		
流動負債	3,538,957	4,174,998
支払手形及び買掛金	1,742,731	1,864,571
短期借入金	551,205	518,900
一年内返済予定長期借入金	548,004	548,004
リース債務	12,572	5,927
未払法人税等	138,031	46,893
賞与引当金	179,410	167,923
前受金	14,490	689,754
その他	352,512	333,023
固定負債	1,807,118	2,261,845
長期借入金	1,017,658	1,565,662
リース債務	179,612	177,903
退職給付引当金	502,208	422,428
その他	107,639	95,852
負債合計	5,346,076	6,436,844
【純資産の部】		
株主資本	5,822,269	4,842,749
② 資本金	1,176,255	922,562
② 資本剰余金	1,128,904	875,211
利益剰余金	3,517,191	3,391,269
③ 自己株式	△ 81	△ 346,293
評価・換算差額等	△ 332,973	△ 500,280
その他有価証券評価差額金	△ 82,001	△ 202,308
繰延ヘッジ損益	—	△ 2,605
為替換算調整勘定	△ 250,971	△ 295,367
少数株主持分	21,077	18,088
純資産合計	5,510,374	4,360,557
負債純資産合計	10,856,450	10,797,402

連結損益計算書

区分	当期 (自 2009年4月 1日 至 2010年3月31日)	前期 (自 2008年4月 1日 至 2009年3月31日)
売上高	9,197,729	10,788,574
売上総利益	4,181,003	4,387,363
販売費及び一般管理費	3,654,356	3,843,987
営業利益	526,647	543,375
経常利益	548,025	320,637
税金等調整前当期純利益	443,300	135,098
当期純利益	292,958	2,408

(単位:千円)

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当期 (自 2009年4月 1日 至 2010年3月31日)	前期 (自 2008年4月 1日 至 2009年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	128,124	1,441,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 986,272	△ 766,844
財務活動によるキャッシュ・フロー	148,119	154,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,445	△ 187,057
現金及び現金同等物の増減額	△ 688,583	641,568
現金及び現金同等物の期首残高	2,496,748	1,855,179
現金及び現金同等物の期末残高	1,808,164	2,496,748

(単位:千円)

株主還元について

将来の事業展開と経営体質の強化のために適正な自己資本比率を維持しつつ、できるだけ配当性向を高めていくことを利益配分に関する基本方針としております。自己資本は、今後の事業活動や経営基盤の強化に有効活用してまいります。

配当金(円)	第48期		第49期		第50期	
	中間	期末	中間	期末	中間	期末
	30	30	30	27	27	27

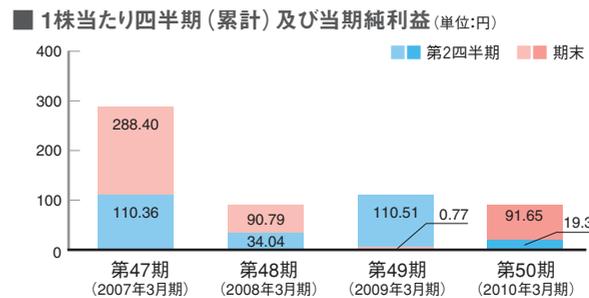
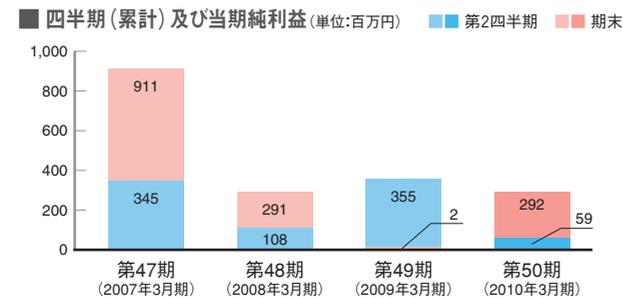
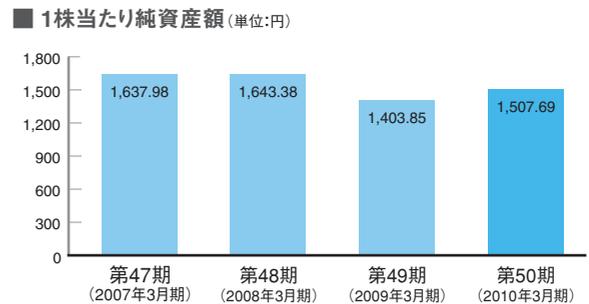
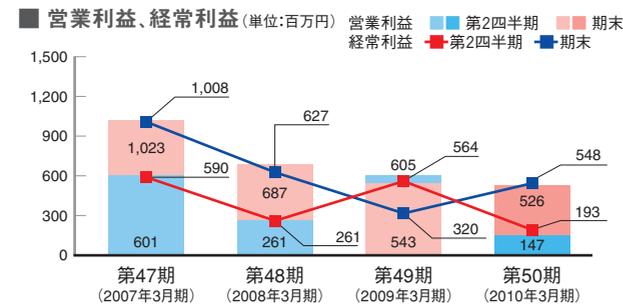
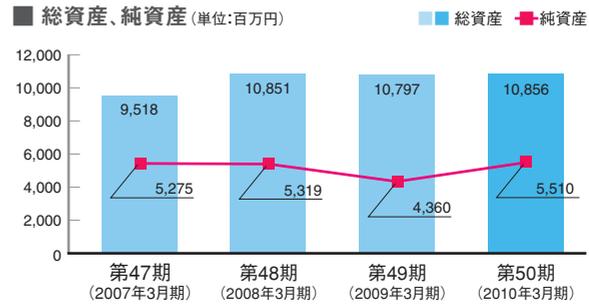
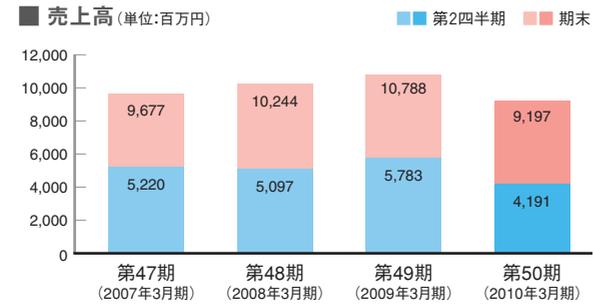
株主優待

当社は、2007年より株主優待制度を導入しましたが、2010年4月1日より優待内容を変更することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

	変更前	変更後
	実施回数	年2回
権利確定日	3月末日、9月末日	3月末日
優待内容	100株以上保有の株主様に、 毎回2,500円相当の品を贈呈	100株以上 — 5,000円相当 500株以上 — 10,000円相当 1,000株以上 — 15,000円相当

なお、今後は、2010年9月末基準日の株主優待はなくなり、2011年3月末基準日の株主優待は変更後の内容で実施いたします。

財務ハイライト (連結)



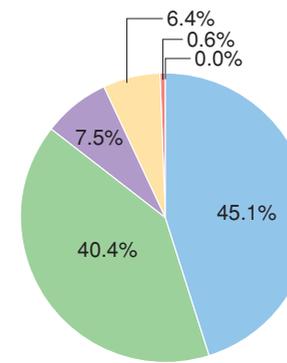
株式の概況 / 会社概要 (2010年3月31日現在)

株式の状況

発行済株式総数 3,640,900株
株主数 6,054名

所有者別株式分布状況

個人・その他 1,643,138株 45.1%
 その他国内法人 1,471,400株 40.4%
 外国人等 272,531株 7.5%
 金融機関 232,000株 6.4%
 証券会社 21,794株 0.6%
 自己名義株式 37株 0.0%



大株主の状況

株主名	持株数(株)	出資比率(%)
粕谷佳允	166,900	4.5
エフ ビー エフ 2000, エル. ビー.	113,500	3.1
日本バーカライジング株式会社	113,500	3.1
日本高純度化学株式会社	110,000	3.0
荏原実業株式会社	100,000	2.7
株式会社S・D・PA	100,000	2.7
日本化学産業株式会社	93,000	2.5
中央化学産業株式会社	82,600	2.2
神谷理研株式会社	80,000	2.1
栄電子工業株式会社	80,000	2.1
株式会社ユニゾーン	80,000	2.1

(注)出資比率は自己株式(37株)を控除して計算してあります。

■ 商号 荏原ユーザライト株式会社
 ■ 本社所在地 東京都台東区台東四丁目19番9号 山口ビル7
 ■ 設立 1968年(昭和43年)4月1日
 ■ 資本金 1,176,255,128円
 ■ 事業所 【国内】
 大阪支店 名古屋支店 高崎支店 浜松営業所
 九州営業所 総合研究所 新潟工場 藤沢工場
 【連結子会社】
 ・荏原ユーザライト(上海)貿易有限公司
 広州分公司
 ・荏原ユーザライト貿易(深圳)有限公司
 蘇州事務所
 ・台湾荏原ユーザライト股份有限公司
 ・EBARA-UDYLITE (KOREA) CO., LTD.
 ・EBARA-UDYLITE (ASIA-PACIFIC) CO., LTD.
 ・EBARA-UDYLITE AMERICA, S.A.DE C.V.
 ・EBARA-UDYLITE VIETNAM CO., LTD.
 ・EBARA-UDYLITE (HONG KONG) CO., LTD.
 【関連会社】
 ・PROGRESSIVE EU CHEMICALS PVT. LTD.
 ・JCU Nanomate 株式会社

■ 役員一覧 (2010年6月29日現在)

代表取締役会長兼最高経営責任者	粕谷 佳允
代表取締役社長兼最高執行責任者	小澤 惠二
専務取締役専務執行役員	大木 繁司
専務取締役専務執行役員	上谷 正明
常務取締役常務執行役員	中澤 隆司
常務取締役常務執行役員	君塚 亮一
常務取締役常務執行役員	山本 雅司
取締役常務執行役員	中村 憲二
取締役常務執行役員	木村 隆男
執行役員	吉川 豊
執行役員	福島 敏明
執行役員	小林 幹司
常勤監査役	大野 寛二
社外監査役	伴 峰夫
社外監査役	岸 富也
社外監査役	高中 正彦

■ 従業員数 連結 300名(54名) 単体 224名(12名)

(注)臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。